

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-33

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>投资者网上集体接待日</u> ）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	投资者网上提问
时间	2023年11月15日
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张丽君；副总经理、财务负责人：楼志勇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>Q1、请问公司是否有计划在未来一段时间内进行股权融资或债务融资，以支持公司的发展和扩大规模？如果有的话，具体的融资计划是怎样的？</p> <p>尊敬的投资者，您好。公司按照投资、经营资金需求合理安排融资计划，目前主要建设项目如广州项目以自有资金和银行融资满足投资需求。感谢您的关注。</p> <p>Q2、深南电路董秘您好！我想了解一下具体的合作模式和合作对象。公司是否有与知名客户的合作案例？这些合作对公司的业务发展有何影响？</p> <p>您好。公司拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项主营业务，公司产品以直销为主，部分产品也会通过代理商进行销售。所处的下游领域包括通信、工控医疗、数据中心、汽车电子、消费电子（封装基板产品为主）等市场，公司所合作的客户覆盖前述领域的众多领先厂商。公司与客户的良好合作关系推动公司长期稳定发展。感谢您的关注。</p>

Q3、请问公司在技术研发方面的投入是否有持续增加？是否有明确的技术研发目标和计划？公司的技术研发团队背景，行业经验如何？

您好。（1）公司长期坚持技术领先战略，持续加大研发投入规模，2023年上半年，公司研发投入占营收比重 6.24%，同比提升 0.49 个百分点。（2）公司在总部、事业部和生产厂层面分别下设研发部、产品研发部和技术部，形成三级研发体系，根据公司每年经营计划制定相应的研发目标和计划。（3）公司重视人才的选育用留，多年来培育出了一支开拓创新、团结进取的研发队伍，主要成员深耕行业多年，具备专业的行业领域知识与经验、具有良好的职业素养。感谢您的关注。

Q4、请问公司产品有无涉及液冷？量有多少？

您好，公司在 PCB 数据中心相关领域未专门区分类似使用场景。感谢您的关注。

Q5、公司好，请问是否有计划加大在 AI 领域的投入和研发？

您好。公司重视数据中心市场，其中有部分 PCB 产品应用于 AI 服务器领域，目前此类产品占比较低，对营收贡献相对有限。随着 AI 领域快速发展，近年来公司持续增加对该领域的投入和市场开发。感谢您的关注。

Q6、请问公司 PCB 业务是否做 5.5G 产品？

您好。通信领域是公司 PCB 业务长期深耕的重要下游市场之一，公司一直保持对行业技术发展趋势的持续跟进及研究，并会根据行业需求做好相应技术储备。感谢您的关注。

Q7、请问公司全年的业绩预期是多少？

您好。公司 2023 年前三季度累计实现营业收入 94.61 亿元，归母净利润 9.08 亿元。关于尚未披露的业绩情况，将在后续定期报告中披露，敬请留意。感谢您的关注。

Q8、张总，请问在董秘办发布日常投资者活动记录表中，深南的许多答案是相同的，甚至是雷同，这是摘要的结果还是每次的回答确实在读标准答案呢

尊敬的投资者，感谢对公司细致及长期的关注，公司参与了线上、现场及策略会等

多种形式及多场的投资者交流，关注的问题确实会有相似及交叉，公司的公告及投资者交流的内容，均按照真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则来进行。感谢您的关注！

Q9、深南电路的股价相对于中证电子 50 指数的估值较低，是否代表着市场对公司的估值存在一定的低估？请问公司是否有任何计划或措施来提升市场对公司价值的认可度？

尊敬的投资者，您好。上市公司的股票价格受多方面因素的影响。公司目前运营一切正常，一方面，公司将继续做优做强主业，努力为广大股东提供更好的投资回报；同时，公司也积极加强与投资者的沟通，让投资者更深度了解公司价值。本年度迄今为止，公司通过线上及现场、策略会等形式与投资者开展互动交流，累计覆盖近 1800 余人次。感谢您的关注！

Q10、您好，针对 ABF 载板的放量进度，请教一下公司对于明年的增长速度有什么样的预期？制定什么增长策略？

您好。公司 FC-BGA 中阶产品目前已在客户端顺利完成认证，面向 FC-BGA 封装基板等产品的广州封装基板项目一期已于 2023 年 10 月下旬连线，目前处于产线初步调试过程中，后续将逐步进入产能爬坡阶段。感谢您的关注。

Q11、公司现在封装基板业务下游需求如何

您好。公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2023 年第三季度，受消费电子等下游市场需求局部修复影响，公司各类封装基板订单环比有所增长。感谢您的关注。

Q12、公司在 AI 领域是否有与其他竞争对手合作的计划？是否有与大型科技公司合作的可能性？

尊敬的投资者，您好。数据中心是公司重视和重点发展的下游市场领域，主要合作客户为科技公司，公司直接供应产品给客户，有部分 PCB 产品应用于 AI 服务器领域，

	<p>目前此类产品占比较低，对营收贡献相对有限。感谢您的关注。</p> <p>Q13、董秘您好！深南电路表示公司坚持技术领先战略，并具备 5.5G 相应技术储备，那么公司在研究行业前沿技术方面有哪些具体的进展和成果？是否有与其他公司的合作或技术引进？是否有针对 5.5G 技术的研发计划和投入？在这个快速发展的行业中，公司如何保持技术优势和竞争力？</p> <p>您好。通信领域是公司 PCB 业务长期深耕的重要下游市场之一，公司一直保持对行业技术发展趋势的持续跟进及研究，并会根据行业需求做好相应技术储备。感谢您的关注。</p> <p>Q14、公司现在的广州封装基板工厂连线爬坡进展如何？</p> <p>尊敬的投资者，您好。公司广州封装基板项目共分两期建设，其中项目一期已于 2023 年 10 月下旬连线试产，目前处于产线初步调试阶段。感谢您的关注。</p> <p>Q15、深南电路是印制电路板龙头企业，为什么股价走势这么弱，都比不过沪电股份和兴森科技。</p> <p>尊敬的投资者，您好。上市公司的股票价格受多方面因素的影响。公司目前运营一切正常。公司将继续做优做强主业，努力为广大投资者提供更好的投资回报。感谢您的关注。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 11 月 15 日